



2026年4月期 決算説明会資料

2026年6月16日

確かな技術とあくなき挑戦で、創造社会を切り拓く

インスペック株式会社



JQA-QMA16212



MS
CM009



(証券コード：6656)

第1部 会社概要

第2部 2026年4月期決算概況

第3部 今後の成長戦略

第1部 会社概要

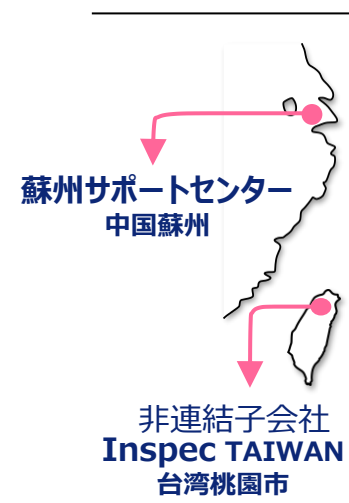
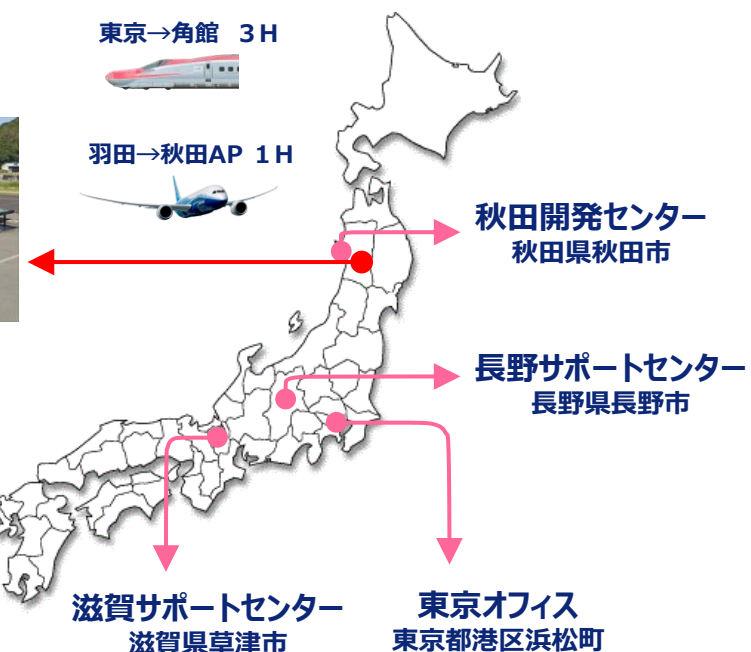
第2部 2026年4月期決算概況

第3部 今後の成長戦略

ハイエンド精密電子部品の外観検査で、グローバルニッチトップ

商号	インスペック株式会社
本社	秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79-1
創業	1984年（昭和59年）1月
上場市場	東京証券取引所スタンダード市場
代表者	代表取締役社長 菅原 雅史
主要製品	1. 半導体パッケージ基板向けAOI 2. 精密FPC向けロールtoロール型AOI 3. 半導体パッケージ基板向けAOS AOI：自動外観検査装置 AOS：レーザーリペア装置
従業員	85名
資本金	813百万円
発行済株式数	4,012,800株（単元株数：100株）
株主数	4,943名

インスペック本社 秋田県仙北市角館町



タイ・ベトナムにサポート体制有り

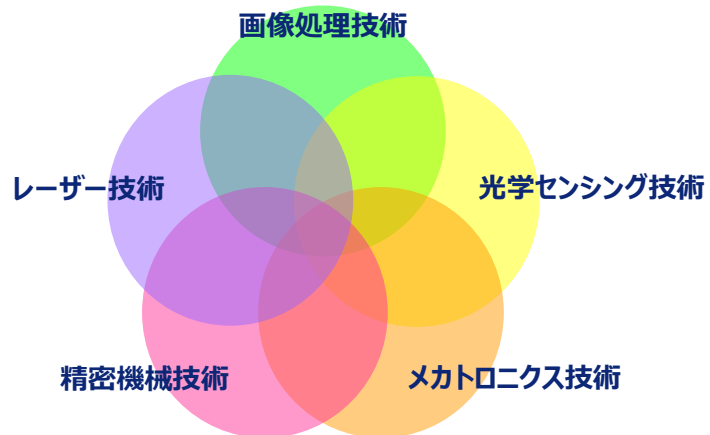


角館の四季

確かな技術とあくなき挑戦で、創造社会を切り拓く

社員が幸せになれる会社、そしてその先の誰もが輝き心豊かに生きることが出来る社会を目指して

確かな技術



あくなき挑戦

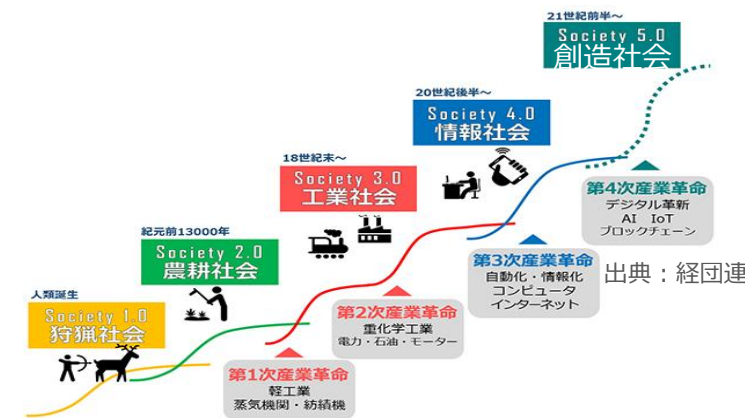


当社の成長を牽引した製品たち



世に出ることはなかったが、現在の事業の礎となった製品たち

創造社会



創造社会とは、「誰もが輝き心豊かに生きることが出来る社会」とあります。

創造社会の実現に貢献するためには、何よりも第一にインスペックの社員が幸せにならなければなりません。

「社員が幸せになれる会社」への取り組みこそが創造社会の実現への取り組みであり、まさにそのことがインスペックの存在意義です。

切り拓く

インスペックは自社が持つ技術・ノウハウを駆使して、まだ見ぬ明日へチャレンジし続けます。

Mission

変化を先取りし、革新的な製品を生み出す

今日の社会は人類が経験したことのない速さで変化が進んでいます。
私たちはこの変化を見据え、その先のニーズを先取りした優れた製品を提供します。

社会の繁栄と
発展に貢献

精密基板検査装置

- ・進化が加速する微細化・高機能化への対応
- ・生産能力増強及びサプライチェーン強化
- ・台湾、東南アジアへの販促強化

新規事業

- ・M&Aを視野に強力な成長エンジンとなる事業の展開を検討

Value

勇気と挑戦



失敗を恐れぬ挑戦と、
たゆまぬ努力が開く未来への扉

信頼と感謝



信頼と感謝が築く、
豊かで限りなき共生の輪

学びと成長



ものづくりは人づくり、
学びと成長はエンドレス

1 高い競争力を持つ最先端の製品を開発し、業界をリードする

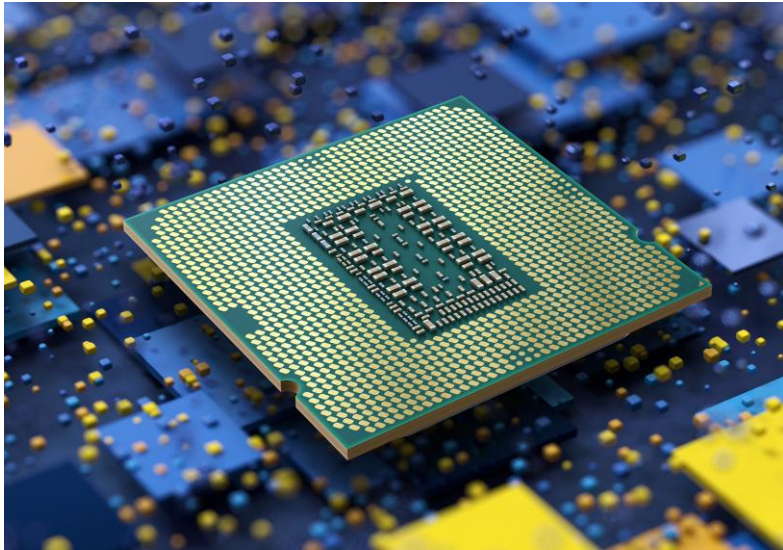
2 収益性の高い、競争力のある事業構造を再構築する

3 アジアを中心としたグローバル市場の進出を拡大する

4 人的資本に積極投資し、持続的成長を支える組織力を強化する

5 働きがいが生み出す力で、社会の繁栄と発展に貢献する

主要製品①：半導体パッケージ基板検査装置



コンピュータのCPU



(パターン検査)

ハイエンドの半導体パッケージ基板向け AOIは世界で数社のみ

(AOI：自動外観検査装置)

← この部品の**検査装置**を作っています



半導体パッケージ基板検査装置 **SXシリーズ**

主要製品②：ロールtoロール型検査装置



スマートフォン分解図
(出典元：iFixit)

FPC基板等の柔軟な基板をベースにした 電子デバイス検査装置

(FPC：フレキシブル基板)

← この部品の**検査装置**を作っています

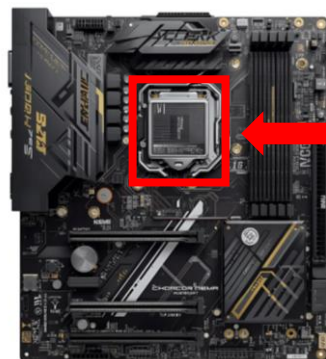


フレキシブル基板検査装置 **RAシリーズ**



ものづくり日本大賞
経済産業大臣賞

第9回 ものづくり日本
大賞・経済産業大臣賞



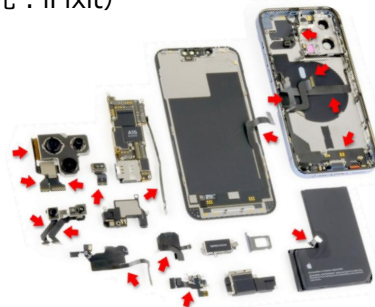
マザーボード



半導体パッケージ基板

最先端の半導体パッケージ基板やフレキシブル基板の品質を担保する役割を担う

スマートフォン分解図
(出典元: iFixit)



精密フレキシブル基板
(出典元: NCネットワーク)

インスペックの製品



半導体パッケージ基板検査装置



ロールtoロール型検査装置

第1部 会社概要

第2部 **2026年4月期決算概況**

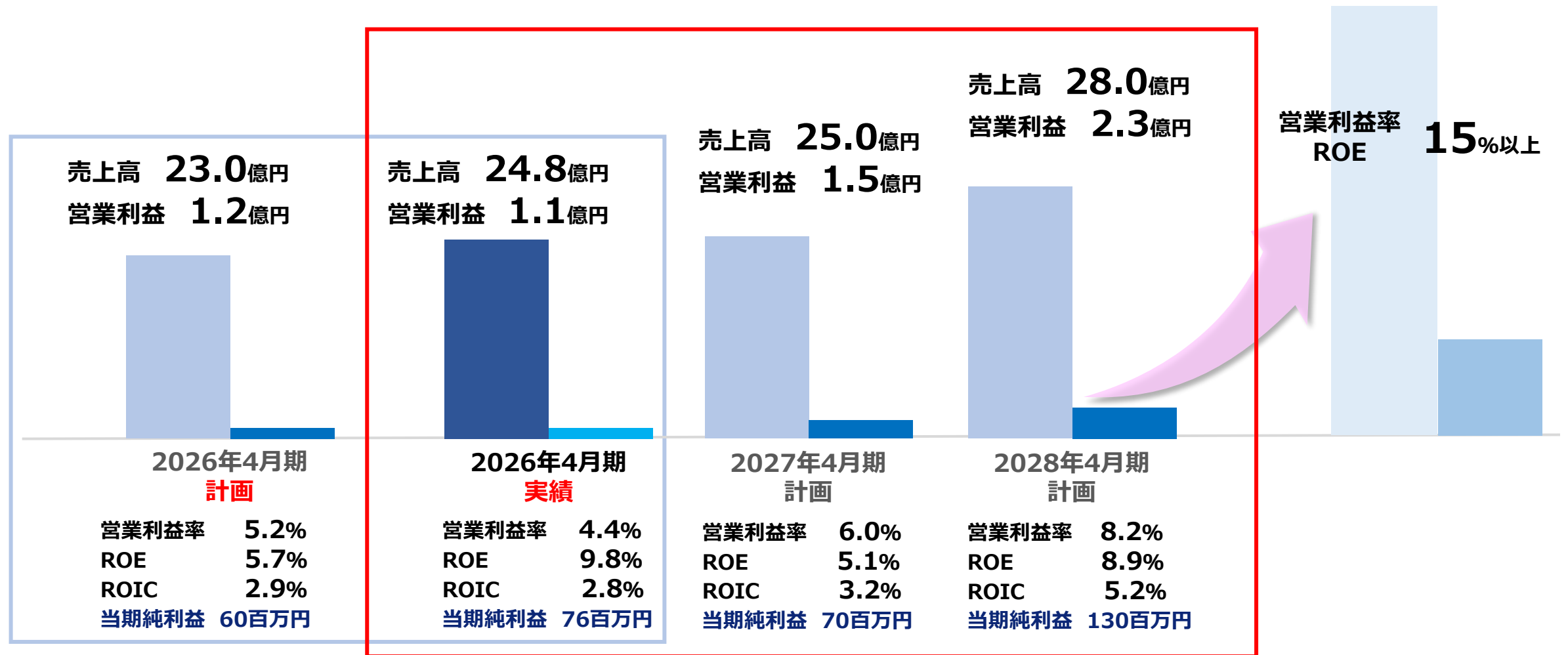
第3部 今後の成長戦略

- ・前期の大型受注を着実に遂行し、売上高は創業以来過去最高を記録
- ・営業利益は、AI対応DC向け最先端半導体パッケージ基板検査装置の新規開発によるコスト増のため粗利率が悪化し、当初計画を下回る

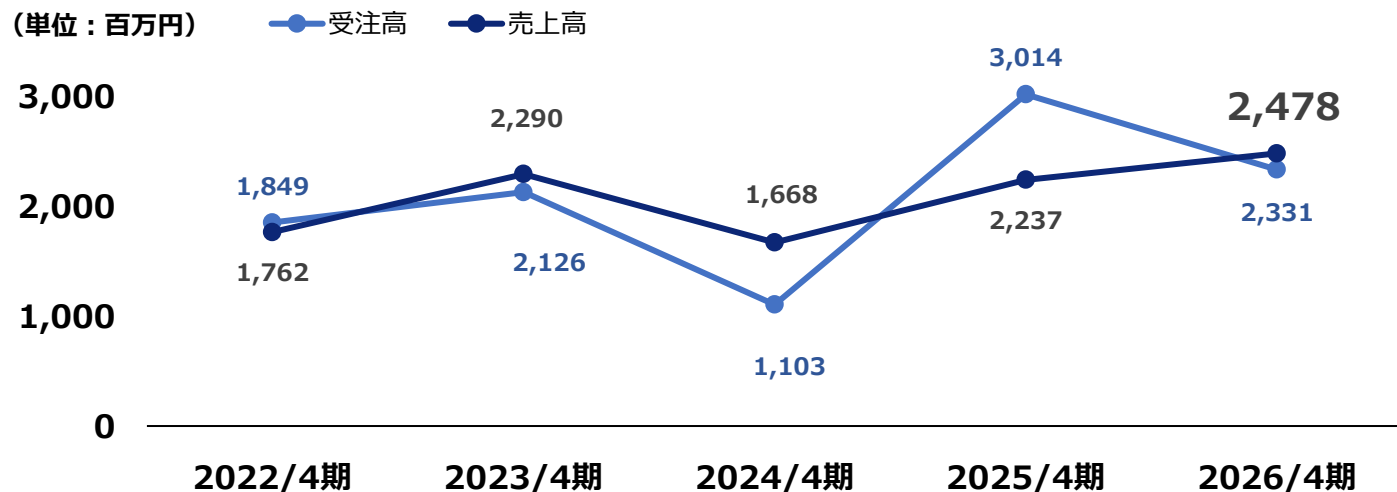
(単位：百万円)

	2026年4月期	2025年4月期	前年同期比	増減率	2026年4月期 業績予想
売上高	2,478	2,237	241	10.8%	2,300
営業利益	108	108	△0	△0.3%	120
利益率	4.4%	4.9%	－	－	5.2%
経常利益	78	116	△38	△32.7%	70
利益率	3.2%	5.2%	－	－	3.0%
当期純利益	76	△142	218	－	60
利益率	3.1%	－	－	－	2.6%

持続的成長で営業利益率15%、ROE15%以上を目指す



過去5年間の推移



過去最高

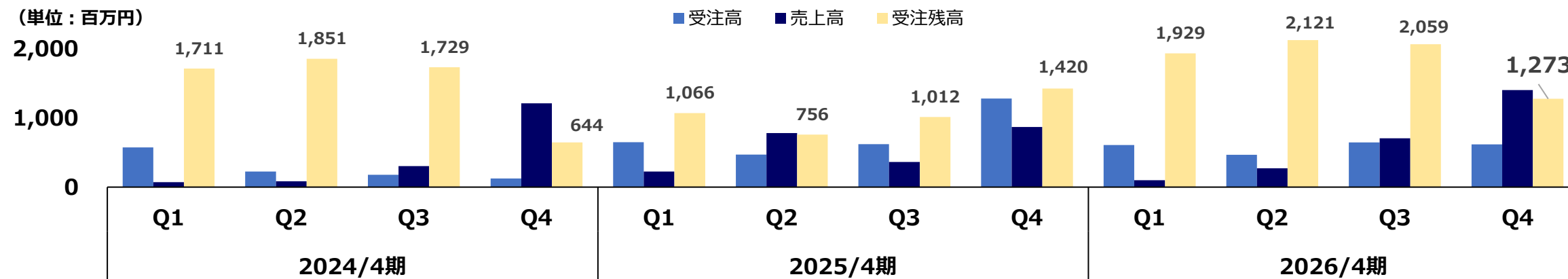
2026/4期売上高

2,478百万円 (前年同期比 10.8%増)

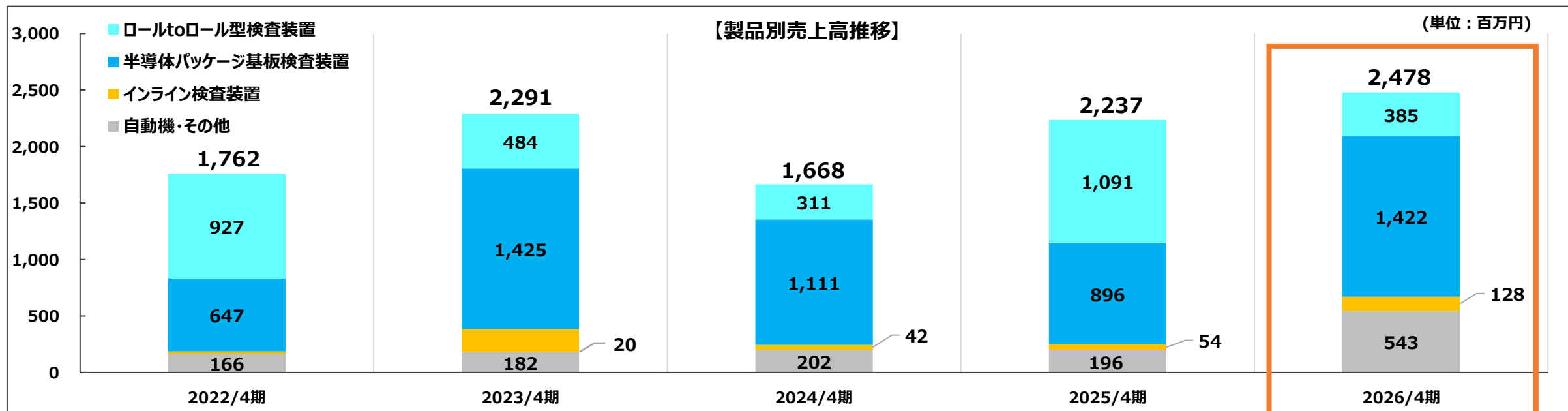
2026/4期末受注残高

1,273百万円 (前年同期比 10.4%減)

四半期毎の推移



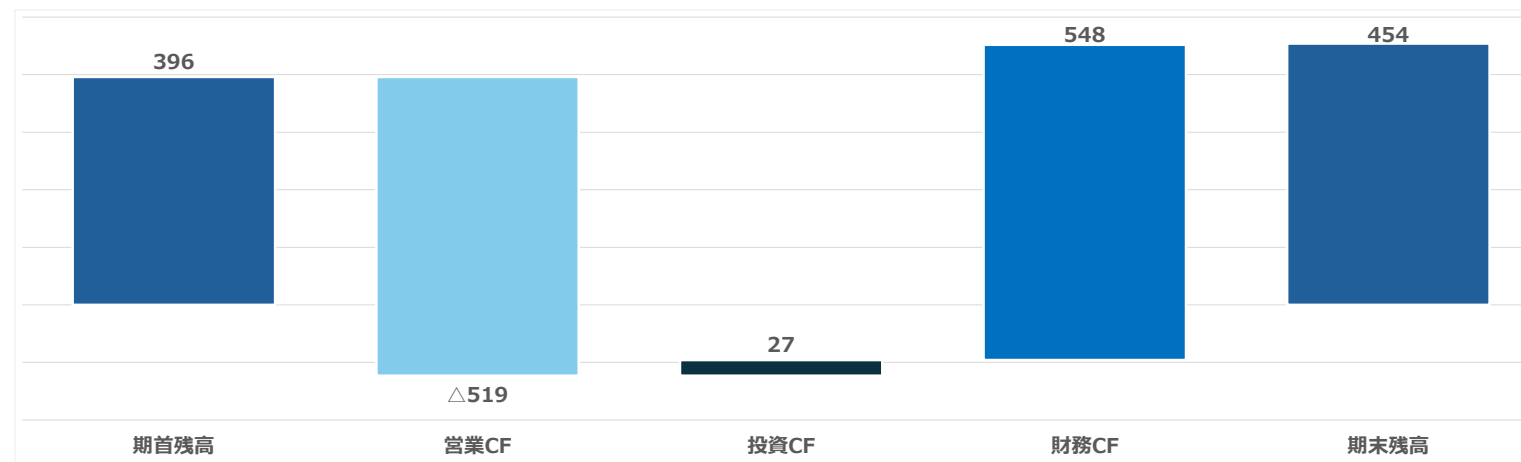
	2025年4月期		2026年4月期		前年同期比 増減率
	金額 (百万円)	構成比	金額 (百万円)	構成比	
売上高合計	2,237	100.0%	2,478	100.0%	10.8%
■ ロールtoロール型検査装置	1,091	48.8%	385	15.5%	△64.7%
■ 半導体パッケージ基板検査装置	896	40.1%	1,422	57.4%	58.7%
■ インライン検査装置	54	2.4%	128	5.2%	134.7%
■ 自動機・その他	196	8.7%	543	21.9%	177.8%



(単位：百万円)

	2025年4月期	2026年4月期	主な増減要因
期首現金及び現金同等物残高	594	396	
営業活動によるキャッシュ・フロー	543	△519	税引前当期純利益81、売上債権の増加△331、棚卸資産の増加△413、契約負債の増加123
投資活動によるキャッシュ・フロー	△66	27	
フリーキャッシュ・フロー	477	△491	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△675	548	短期借入金の純増減額 720、長期借入金の返済△154
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	
現金及び現金同等物の増減額	△198	58	
期末現金及び現金同等物残高	396	454	

現金及び現金同等物
58百万円の増加



	2026年4月期		2025年4月期		対前年 増減率
	金額（百万円）	対売上比	金額（百万円）	対売上比	
基板検査装置関連事業 （精密基板検査装置）	256	10.3%	252	11.2%	1.5%
露光装置関連事業	—	N/A	105	N/A	N/A
合 計	256	10.3%	358	16.0%	△28.5%

■ 基板検査装置関連事業（精密基板検査装置）／半導体パッケージ基板検査装置・FPC検査装置

- ・次世代及び次々世代の半導体パッケージ基板向けのウルトラファインAOIの開発
- ・次世代リペア装置（AOS：光学式自動シェイピング装置）の開発

■ 露光装置関連事業／ロールtoロール型直描露光装置

- ・2025年3月に事業撤退

第1部 会社概要

第2部 2026年4月期決算概況

第3部 今後の成長戦略

米国の通商政策の影響や地政学リスクの高まりにより、不確実性の高い状況が継続
半導体市場においては、AI半導体関連を中心に技術の発展、進化のスピードが加速

2026年4月期～2027年4月期

マ
ク
ロ
経
済

- ・中東情勢緊迫化等による地政学的リスクの高まり
- ・先進国の少子高齢化による人手不足
- ・新興国の経済成長率拡大
- ・IoT・AIをはじめとするDX推進の加速
- ・サステナビリティに対する世界的な危機感の高まり

マ
ー
ケ
ッ
ト

- ・シリコンサイクルからスーパーサイクルへ
- ・国・地域による半導体産業支援政策の強化
- ・AI向け半導体の需要拡大
- ・FPCの高付加価値用途へのシフト
- ・フィジカルAIの適用領域の拡大

事
業
環
境

- ・AI向けDCへの大規模投資継続による半導体パッケージ基板及びインターポーター向け検査装置の新規需要の高まり
- ・半導体プロセスの微細化や、チップレット化へ向けた国内外企業の投資が活発化
- ・AI搭載スマートフォン需要の増加

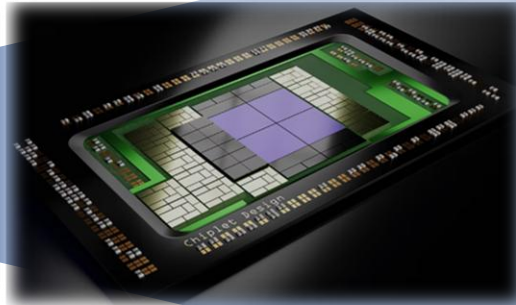
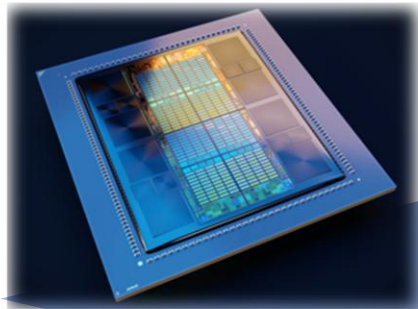
持続的成長と企業価値創造

確かな技術で競争力の高い製品を生み出し、
社会の発展に貢献

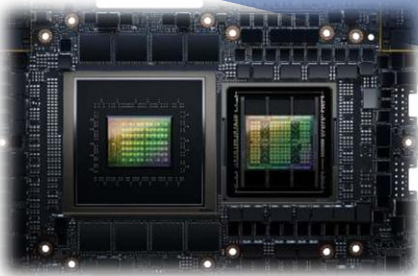
AIの加速度的進化に伴い、
高性能半導体の市場拡大

半導体・FPC検査の
微細化・高度化対応

AIの急速な普及を背景に、DC向けの活発な投資が継続 高性能半導体パッケージ基板の重要性の一層の高まりと需要の拡大



チップレット
(出典元：東京エレクトロン)

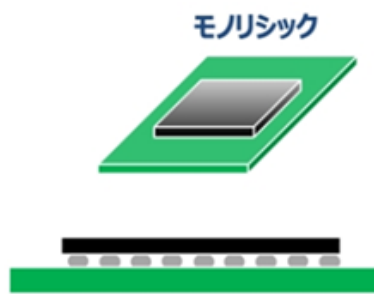
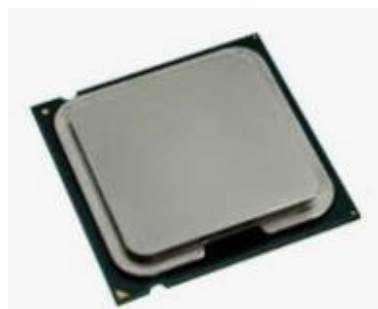


NVIDIA GH200 Grace Hopper
(出典元：NVIDIA)



データセンター
(出典元：ソフトバンク)

チップレット化の進展により、パッケージが半導体性能を牽引する時代へ

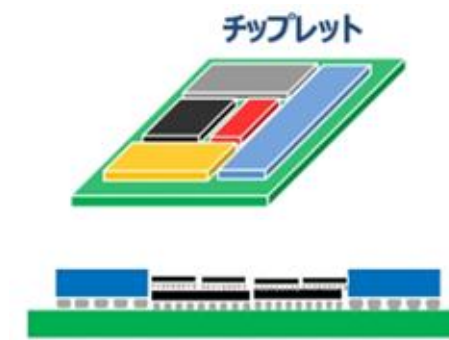
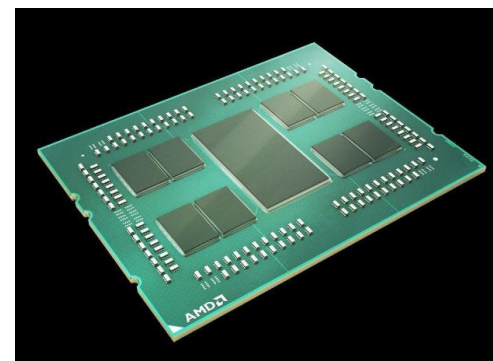


出典元 OMRON

以前のPKG基板 (L/S=9/12 μ m)

※L/S=ライン/スペース：配線の幅と隣り合う配線同士の間隔

チップレット化



出典元 OMRON

(L/S=5/5~2/2 μ m)

※チップレット：複数の小さなチップを組み合わせる一つの高性能チップのように動かす技術

チップレット化のメリット

◆コスト最適化と供給安定

大きな一体チップより不良が減り、製造コストを抑えやすい

◆性能/電力の効率改善

計算・通信・メモリなどを得意な作り方で分担し、
全体の性能/消費電力を改善

◆開発スピードと製品ライン最適化

必要な部品だけ改良・差し替えでき、リードタイム短縮とリスク低減

パッケージの重要性が一層高まり、前工程メーカーが
後工程へ参入するなど設備投資が活況

半導体パッケージ基板検査装置の
市場拡大・需要増

AIサーバーの拡大で、高性能CPU・GPUなどのハイエンドデバイスが急増 微細化、チップレット化で、より高機能化する半導体パッケージングへ対応する検査装置の開発と販売強化

1. 半導体パッケージ基板の微細化・高度化への対応

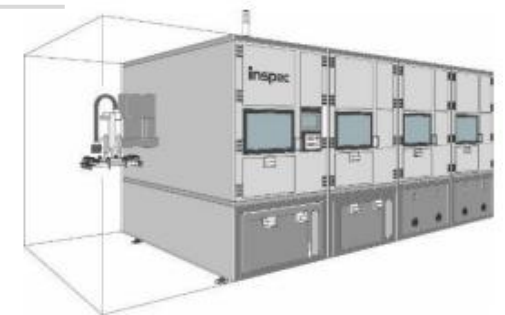
- ・L/S=5μm/5μm→L/S=1μm/1μm
- ・ガラス基板等への応用
- ・基板パッケージサイズ大型化へ対応



半導体パッケージ基板検査装置
SXシリーズ

2. 全自動化システムの更なる進化

- ・AIサーバー拡大により高性能なCPU
及びGPUが急増
- ・拡大する高性能検査装置ニーズへ対応



AI機能付両面全自動検査装置

3. FPCの需要拡大への対応

- ・AI搭載スマートデバイス向けFPC需要増
- ・ロール状での圧倒的高速検査を実現した
主力製品の更なる進化



ロールtoロール型FPC検査装置
RAシリーズ

4. 更なる成長へ向け、事業基盤強化

- ・生産能力増強
- ・サプライチェーン強化
- ・海外拠点の強化
- ・東南アジア地域への販促強化



次世代最先端検査システムの開発を推進

次世代CPU・GPUなどのハイエンドデバイスにおけるチップレット化で、より高機能化する半導体パッケージングへ対応する検査装置を開発



L/S=5 μ m/5 μ m

L/S=2 μ m/2 μ m

L/S=1 μ m/1 μ m



SX7300

SX7400

SX7500

※SXシリーズ
半導体パッケージ基板向けAOI
(AOI:自動外観検査装置)

AIが作り出す未来に SX7000シリーズが貢献

次世代トレンド



ガラス基板
(出典元:東京エレクトロン株式会社)

半導体パッケージ基板は
有機基板からガラス基板へ

検査からリペアまで一貫したソリューションを提供

AIやDC市場の拡大とともに、生産現場のニーズが多様化・高度化
お客様の生産効率向上と歩留まり改善に貢献

チップレット化の加速

- ・ L/S=5/5~2/2 μ mとなり歩留り低下
- ・ 高機能チップレット基板の価格が高騰
- ・ L/S=10/10 μ m以下に対応可能なリペア機のニーズ拡大

高密度実装を可能にするインターポーターの需要増加

- ・ チップレット化で、半導体パッケージ基板が
高機能化・高密度化・多層化し、検査装置に対しても、
より高精度かつ高性能な検査能力が不可欠に

※インターポーター：複数のチップレットを高密度で接続するための中間基板で、シリコンや有機材料で構成される。チップレット技術を支える重要な役割を担っている。



次世代半導体パッケージ基板
検査装置

SX7300 / SX7400

L/S=2.0 μ m~1.5 μ mに対応

レーザーリペア装置
LX7000

微細パターンに対応



**チップレット化、微細配線化に対応する
次世代半導体パッケージ基板向け製品をリリース**

マーケットの動きに応じて販売及びサポート体制を強化



サポートセンターを拡充

長野県と滋賀県にサポートセンターを設置し、主要なお客様へ、迅速かつきめ細かいサービスを提供。

海外での本格的な販促活動の開始とサポート体制の強化

台湾の現地法人である台湾英視股份有限公司の事務所にデモ機を設置し、本格的に販促活動をスタート。

加えて、お客様のニーズに柔軟に対応するため、中国蘇州にサポートセンターを設置。

国内外で展示会に出展



- 日本： JPCA Show
ネプコンジャパン
SEMICON JAPAN
- 中国： HKPCA SHOW
CPCA Show
SEMICON CHINA
- 台湾： TPCA Show
SEMICON TAIWAN
- タイ： THECA Show

- ・AI向けDCの大規模投資に伴う、半導体パッケージ基板市場の拡大は継続
- ・当社が強みを持つ高性能検査装置需要は当面堅調に推移すると予想

(単位：百万円)

	公表値	前期実績	増減	増減率
売上高	2,500	2,478	22	0.8%
営業利益	150	108	42	38.4%
利益率	6.0%	4.4%	—	—
経常利益	100	78	22	27.1%
利益率	4.0%	3.2%	—	—
当期純利益	80	76	4	4.1%
利益率	3.2%	3.1%	—	—

人的資本に積極投資し、持続的成長を支える組織力を強化する

人事評価制度のブラッシュアップ

・社員の働きがいの向上を目指し、個が輝く人事制度を構築

2026年5月実績
・初任給引上げ 3.8%~5.3%
・ベースアップ 2.5%

教育研修制度の充実

・人材育成プログラムを策定し、運用中

多様な働き方の支援

・時間単位の有給休暇と有給病気休暇の導入

ダイバーシティ採用へ

- ・地元採用による地域リレーション維持
- ・リモートワークを前提とした採用
- ・グローバル市場進出拡大に応じた多様な人材の採用

従業員エンゲージメントの向上

企業価値向上

IR・PR強化

知名度・認知度向上

「働きがい」「従業員エンゲージメントの向上」を目指す

教育研修制度の充実

- ・ 「学びと成長」を重視し、全社員を対象に学習機会を提供
- ・ 階層別研修や専門基礎知識研修を実施

多様な働き方の支援

- ・ 高年間休日、有給休暇の奨励
- ・ 仕事と子育て・介護との両立支援の強化により福利厚生を拡充

ダイバーシティ

- ・ 多様な人材の採用
- ・ 女性社員の活躍推進
- ・ 「秋田開発センター」を開設による勤務場所の選択肢を拡充

賃上げ率

8.2%

2026年5月実績

有休取得率

71.0%

2026年4月期実績

女性管理職比率

7.4%

2026年5月現在

研修時間

40~50h

2026年4月期実績

男性育児休暇
取得日数平均

91.5日

2026年4月期実績

基本方針

当社は、パーパスのもと、精密基板検査装置事業の成長の持続と稼ぐ力の向上で企業価値拡大を図り、**ROE15%以上**を目指し、**PBR向上**を図ります。

ROEとROICの推移

	2022/4期	2023/4期	2024/4期	2025/4期	2026/4期
ROE	18.6%	7.3%	△33.4%	△17.4%	9.8%
ROIC	0.6%	2.5%	△5.0%	2.7%	2.8%

株主資本コストの算出

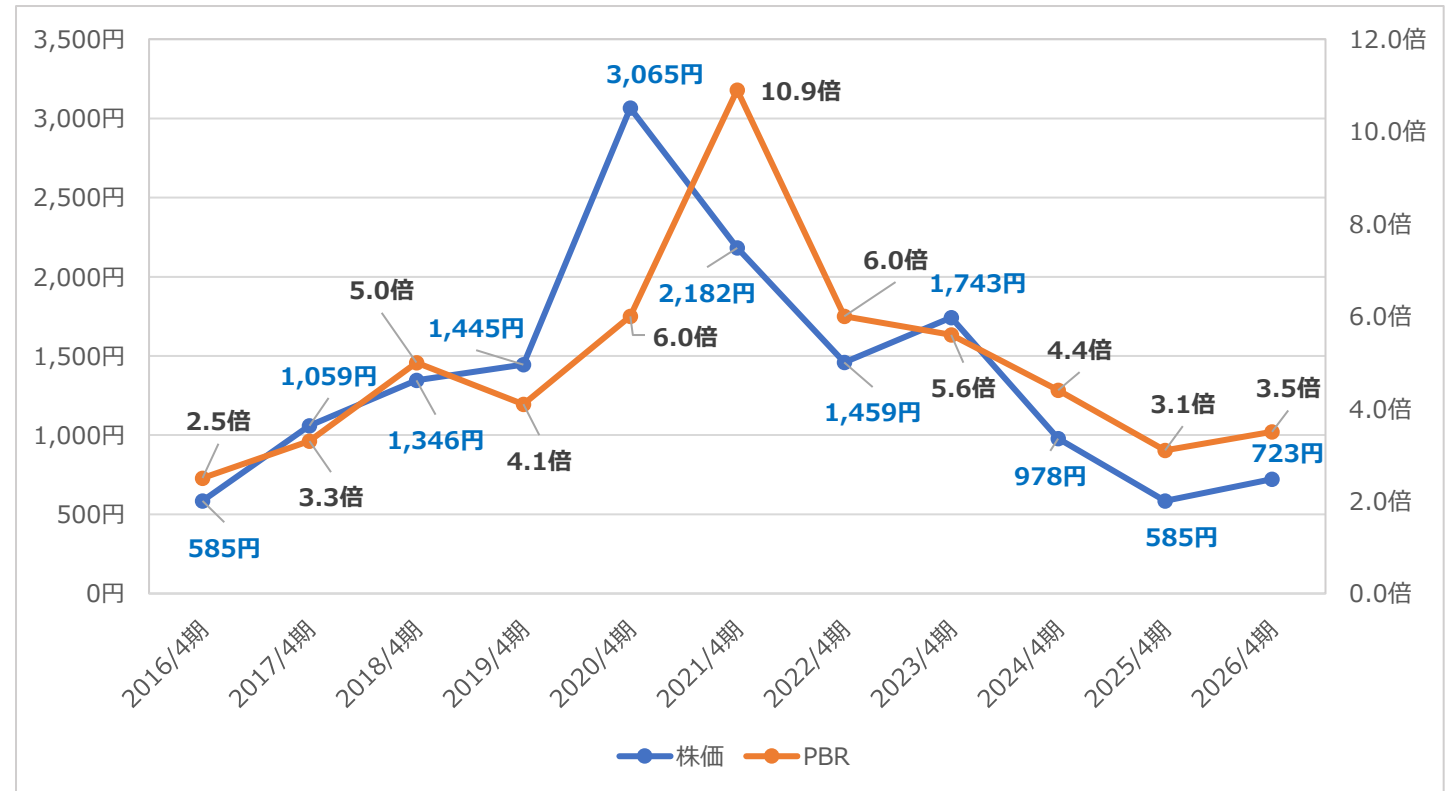
CAPM（資本資産価格モデル）による算出

$$\begin{array}{l}
 \text{リスクフリーレート} \\
 \text{安全資産の収益率、} \\
 \text{無リスク利子} \\
 \text{10年物国債利回り} \\
 0.75\% \sim 2.38\%
 \end{array}
 +
 \begin{array}{l}
 \text{ベータ (}\beta\text{) 値} \\
 \text{当社株式固有の} \\
 \text{リスク尺度} \\
 1.00\% \sim 1.57\%
 \end{array}
 \times
 \begin{array}{l}
 \text{マーケットリスク} \\
 \text{プレミアム} \\
 \text{株式投資に期待} \\
 \text{する超過収益率} \\
 5.88\% \sim 6.59\%
 \end{array}
 =
 \begin{array}{l}
 \text{株主資本コスト} \\
 7.0\% \sim 10.7\% \\
 \text{(3期平均9.7\%)}
 \end{array}$$

配当の推移

	2022/4期	2023/4期	2024/4期	2025/4期	2026/4期
1株当たり配当	3円	3円	-	-	-

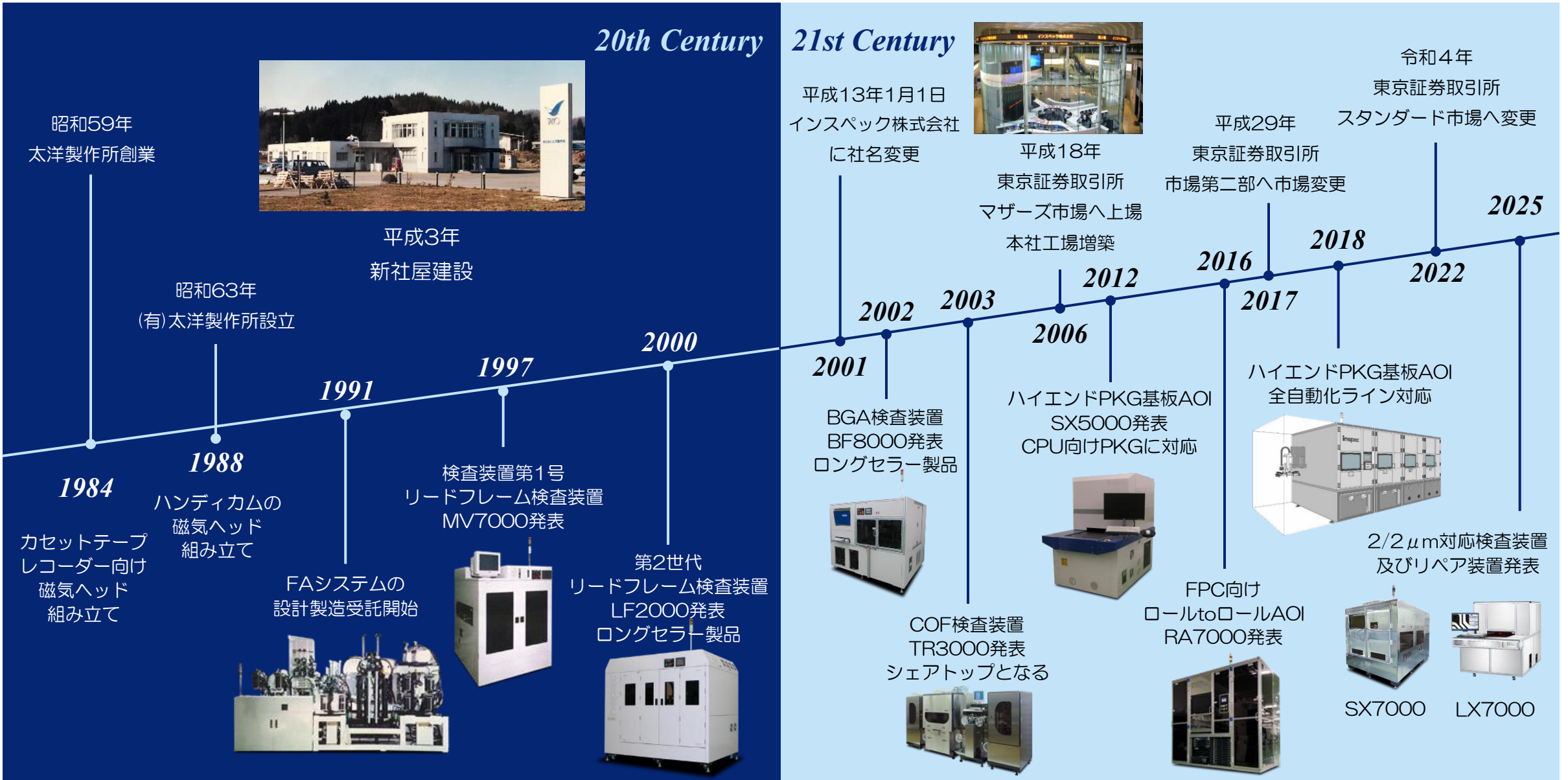
PBRと株価の推移



Appendix

20th Century

21st Century



CG基本方針

当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンスを徹底するため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。今後も企業価値を継続的に高めていくため、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくことを経営上の最も重要な課題のひとつと位置づけております。

● 取締役会の機能強化

- ・公正かつ透明性の高い情報開示
- ・定期的な取締役会実効性評価の実施と評価結果の活用
- ・独立社外取締役の増員検討
- ・取締役・監査役のトレーニング
(方針の策定と教育・研修プログラムの検討)

● 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

- ・財務構造の最適化
- ・成長戦略及び配当政策の策定
(中期経営計画)
- ・株主や投資家とのコミュニケーションの強化

当社は、パーパス「確かな技術とあくなき挑戦で、創造社会を切り拓く」を通じて、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指します。

活力ある職場づくり

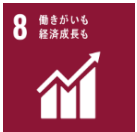
交流・能力開発・仕事と生活の調和によって働きがいのある職場づくり



- 支援学校実習受け入れ
- インターンシップ受け入れ



- 女性社員の雇用・活躍の推進
- 出産・育児・介護休暇の取得推進



- 有給休暇取得推進
- 外部研修の実施



マネジメントスキル研修



角館武家屋敷清掃活動

技術開発

検査装置の開発を通じて技術革新に貢献



- 欠陥自動分類技術による人手不足解消への貢献
- 電気自動車等のグリーンエネルギー技術発展への貢献

社会貢献活動

地域社会をはじめとした社会貢献活動を推進



- 開発途上国にワクチン提供支援 (ペットボトルキャップ・古着回収)
- 社内献血活動



- 再生可能エネルギー100% (RE100)の電力を導入



- 角館武家屋敷清掃活動
- 地元災害ボランティアへの登録



- フードロス対策自販機の社内設置
- 社内空調にガスエアコンを使用
- 照明のLEDライト化



- あきたSDGsパートナー登録
- 地元スポーツ団体への協賛



私たちは秋田ノーザンハピネットを応援しています

プロバスケットボールチームオフィシャルスポンサー



半導体パッケージ基板向けAOI『SX5600』

- インスパック基板AOIのフラッグシップモデル
- 最先端の次世代高精細基板に対応
- クラス最速レベルの生産性を実現



ロールtoロール型FPC検査装置『RA7400』

- ノンストップで高スループットと長尺対応の実現
- ベリファイレスをサポートする自動欠陥分類機能搭載
- コンパクトな外形

本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としたものではありません。

本資料を作成するに当たっては、正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。

本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及又は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることをご承知おきください。